

2021年度共同研究新規課題募集要項

東京医科歯科大学生体材料工学研究所、東京工業大学未来産業技術研究所、広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所及び静岡大学電子工学研究所の4研究所は、ネットワークを構築してそれぞれの強み技術を融合し、生体医歯工学に関する共同研究拠点を設置しております。

この度、2021年度の生体材料、生体工学、生体機能分子、化学・電気・機械・材料工学の生体応用など医歯工融合に関する基礎研究及び応用研究について、以下により共同研究を募集します。

なお、2021年度は本共同研究拠点事業の最終年度であることなどを踏まえ、迅速な研究開始を図るためにも新規課題募集のスケジュールを例年よりも早めております。

1. 募集テーマ

【研究領域】

- 1) 生体材料に関する基礎・応用研究
- 2) 生体工学に関する基礎・応用研究
- 3) 生体機能分子に関する基礎・応用研究
- 4) 化学・電気・機械・材料工学の生体応用研究

2. 申請資格者・研究組織

- (1) 2021年4月1日の時点で、大学・研究機関、企業の研究者またはこれに相当する方。
- (2) 研究組織には、本拠点（4研究所）所属の研究者を含むものとします。

3. 研究期間

2021年4月1日から2022年3月31日

4. 申請方法

- (1) 申請者は、研究課題、参加予定者、及びその他必要と認められる事項について、事前に本拠点（4研究所）の研究者と打合せを行い、申請して下さい。
- (2) 本拠点（4研究所）の概要（施設、所属教員名、研究概要）等については、ホームページをご覧ください。（<http://www.tmd.ac.jp/ibbc/>）
- (3) 共同研究の申請は生体医歯工学共同研究申請書（様式1）を、申請者が直接メールで提出してください。

なお、提出する同申請書は Wordで作成された申請書（原稿）ファイルと、申請書をPDF化したファイルの2種類をメールで下記宛に提出してください。

- (4) 同申請書の提出先は、事前に本拠点（4研究所）の研究者と協議し、共同研究を承諾した同研究者の所属する研究所の拠点事務局に提出してください。

【提出先】

ア. 東京工業大学未来産業技術研究所/生体医歯工学共同研究拠点事務局

E-mail : ken.mirai@jim.titech.ac.jp

イ. 静岡大学電子工学研究所/生体医歯工学共同研究拠点事務局

E-mail : rie-soumu@adb.shizuoka.ac.jp

ウ. 広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所/生体医歯工学共同研究拠点事務局

E-mail : rcbio-adm@hiroshima-u.ac.jp

エ. 東京医科歯科大学生体材料工学研究所/生体医歯工学共同研究拠点事務局

E-mail : rcbio.adm@tmd.ac.jp

5. 申請期限

2021年1月12日（火）（期限厳守）

6. 選考及び採択通知

共同研究の選考は、拠点内で協議し決定します。採否の結果は、2021年3月以降に申請者へ通知します。

7. 共同研究実施報告書の提出

採択された申請者は、研究終了後に共同研究実施報告書を提出してください。同報告者の様式、提出期限等については別途通知します。

なお、提出された同報告書については、本拠点が必要とする範囲内において拠点ホームページ等で公開します。

8. その他

(1) 動物実験研究や、ヒト試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験などについて生命倫理・安全対策への取り組みを必要とする研究については、法令等に基づき拠点内外の委員会等による承認手続き、教育訓練の受講などが必要となる場合があります。

(2) 知的財産権の取扱いは、本拠点における各研究所の知的財産権に関する取り扱い基準に準じます。

(3) 施設・設備の利用については、共同研究に必要な拠点の施設・設備を利用することができます。詳細については事務局にお問い合わせください。

(4) 共同研究による成果の発表については、学術論文、学術集会等で本共同研究の成果を発表する場合には、必ず本共同研究による旨を明記してください。

This study was supported by the Research Center for Biomedical Engineering.

(5) 問い合わせ先

ア. 東京医科歯科大学生体材料工学研究所/生体医歯工学共同研究拠点事務局

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-3-10 電話：03-5280-8059

E-mail : rcbio.adm@tmd.ac.jp

イ. 東京工業大学未来産業技術研究所/生体医歯工学共同研究拠点事務局

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田 4259-R2-2 電話：045-924-5965

E-mail : ken.mirai@jim.titech.ac.jp

ウ. 静岡大学電子工学研究所/生体医歯工学共同研究拠点事務局

〒432-8011 静岡県浜松市中区城北 3-5-1 電話：053-478-1301 (内線 1301)

E-mail : rie-soumu@adb.shizuoka.ac.jp

エ. 広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所/生体医歯工学共同研究拠点事務局

〒739-8527 広島県東広島市鏡山 1-4-2 電話：082-424-6265

E-mail : rcbio-adm@hiroshima-u.ac.jp